

# 大電流・高放熱 プリント基板

— 基板の常識を変える —



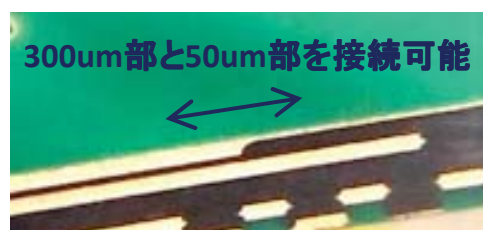
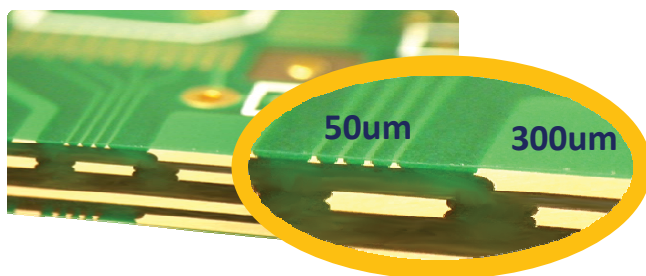
## 大陽工業株式会社



使いたいパワーデバイスが小型狭ピッチで厚銅箔を使いたくてもパッドが形成できない。いつもの35um銅箔の基板で電流値が足りるだろうか…

## 異型銅厚共存基板

300umの厚銅箔と50umの薄銅箔を同一層に共存可能な基板  
300um部と50um部の接続も自由自在

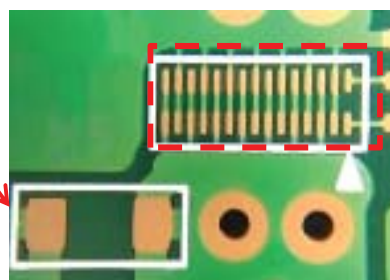


電流値が大きいので厚銅箔を使いたいけれど、狭ピッチで厚銅箔ではパッドを作れないようなGaNデバイスも…



3216サイズチップ部品

パッケージサイズ: 6.05mm × 2.3mm  
パッド幅: 0.18mm パッド間隔: 0.4mm



赤点線内は50umで狭ピッチパッドを形成  
その先のベタパターンは300umにて形成し大電流に対応

※UL取得済み

大電流・高放熱基板は大陽工業(株)にご相談ください!

<http://www.taiyo-technology.jp/>



バスバー代わりに基板を使ってコストダウンしたいけど  
100Aを超えるような大電流って基板に流せるのかな？

## 大電流基板

※弊社実績 MAX 1100A

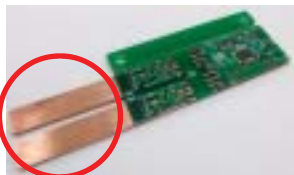
銅箔厚 最大2000um(=2mm)まで  
電流値や用途に合わせて自由な銅箔厚の組合せができる大電流対応基板



L1: 300um 異型銅厚  
L2: 1000um  
L3: 70um  
L4: 300um 異型銅厚



500um以上は  
銅箔のみ  
基板の外へ  
引き出しが可能



引き出した銅箔を端子として  
直接部品をネジ止めすることも可能  
また、折り曲げ加工も可能

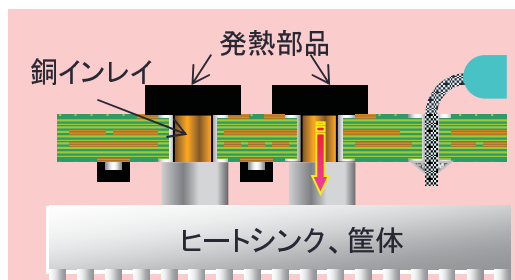
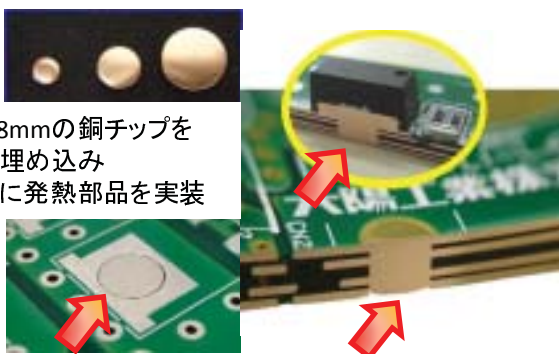


GaN や SiC などのパワーデバイスを  
低コストで効率よく放熱するのに良い方法はないかな？

## 銅インレイ基板

銅インレイ＝パワーデバイスの熱を基板の真裏へダイレクトへ伝える放熱経路  
放熱したい部品の実装形態や高さを選ばないため設計自由度が大幅にアップ

φ3～φ8mmの銅チップを  
基板に埋め込み  
その上に発熱部品を実装



基板の裏に筐体やヒートシンクを用意して  
部品で発生した熱を一気に放熱

※たくさんのご要望にお応えして電流経路にも使用できる銅インレイを開発しました！  
詳しくは営業までお問い合わせください。

大陽工業株式会社 プリント回路カンパニー

<http://www.taiyo-technology.jp/>

「銅インレイにゃん」で 



プリント回路カンパニー  
マスコットキャラクター